

ELECTRICALLY CONDUCTIVE PAINT

Patent number: JP58103565
Publication date: 1983-06-20
Inventor: OGAWA YASUHIRO; SHINODA SANKICHI;
TAKESHIMA AKIYOSHI
Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD
Classification:
- international: C09D5/24
- european:
Application number: JP19810202208 19811214
Priority number(s): JP19810202208 19811214

[Report a data error here](#)

Abstract of JP58103565

PURPOSE:To provide an electrically conductive paint which consists of Ag-Be-Cu type conductive powder, resin and solvent and is low cost and excellent in electrical conductivity and migration characteristics. CONSTITUTION:Powdered alloy with a particle diameter of 0.05-10μ, consisting of 10-70wt% Ag, 0.1-3wt% Be and balance Cu, is dipped in an organic solvent solution of 1,2,3-benzotriazole. Upon separation of the solvent and drying, electrically conductive powder surface coated with a thin film of a chelate compd. is obtained. Then the conductive powder, a thermosetting resin (e.g. xylene resin) and a solvent (e.g. ethyl carbitol) are kneaded to produce an electrically conductive paint. The paint is applied to phenolic resin substrate, etc. by screen printing, etc. and is cured in the air under heating to form electrode and conducting path.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

⑯ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭58—103565

⑮ Int. Cl.³
C 09 D 5/24

識別記号

厅内整理番号
6516—4 J

⑯ 公開 昭和58年(1983)6月20日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 4 頁)

⑩ 導電性ペイント

⑪ 特 願 昭56—202208

⑫ 出 願 昭56(1981)12月14日

⑬ 発明者 小川泰弘

門真市大字門真1006番地松下電器産業株式会社内

⑭ 発明者 信太三吉

門真市大字門真1006番地松下電器産業株式会社内

⑮ 発明者 竹島明美

門真市大字門真1006番地松下電器産業株式会社内

⑯ 出願人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

⑰ 代理人 弁理士 中尾敏男 外1名

明細書

1、発明の名称

導電性ペイント

2、特許請求の範囲

(1) 導電粉、樹脂および溶剤からなり、導電粉が少なくとも Ag 10~70重量%と BeO 1~3重量%を含有し、残部が Cu の組成からなる合金粉であることを特徴とする導電性ペイント。

(2) 合金粉が、1, 2, 3-ベンゾトリアゾールを有機溶媒に溶かした溶液に浸漬後、前記溶液と分離し、乾燥させたものであることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の導電性ペイント。

3、発明の詳細な説明

本発明は導電性ペイントに関し、安価で導電性にすぐれ、しかも耐マイグレーション性にすぐれた導電性ペイントの提供を目的とするものである。

従来、この種の導電性ペイントには、導電粉として Au, Ag, Pd などの貴金属粉が用いられてきた。一般的には、導電粉に Ag を用い、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、キシリソ樹脂などの熱

硬化型樹脂とエチルカルビトールのような溶剤と共に混練した Ag ベイントを、フェノール樹脂基板などにスクリーン印刷等の方法で塗布した後、加熱硬化し、可変抵抗器などの電極、あるいは電子回路用の位刷配線導体として使用されてきた。

しかし、近年電子機器の小型化や薄型化に伴ない電子部品の小型化が強く要望される傾向にあり、このような状況下では、Ag ベイントの使用が、Ag ベイント硬化膜中の Ag が大気中の湿気と直流電界との相互作用により、Ag ベイント電極相互間を移行する現象、いわゆるマイグレーションを起こし、その結果回路の短絡を起こし、しばしばトラブルの大きな要因となっている。

このような Ag ベイントの欠点を補うために、Ag-Pd 粉を用いた導電性ペイントが市販されているが、まだ完全とはいえない。また、Ag-Pd 粉を用いた導電性ペイントは、Pd の価格が Ag の価格に較めて高く、さらに、貴金属類特に Ag の価格高騰が激しい近年の情勢では、経済性の点で極めて不利である。

以上のような理由から、耐マイグレーション性の良い安価な導電性ペイントの出現が望まれている。

本発明はこのような点に鑑みて成されたものであり、発明者らは、半金属を主成分とする合金粉を調査検討した結果、Ag-Ba-Cu合金粉を導電粉とした導電性ペイントが、耐マイグレーション性にすぐれ、しかも導電性をかなりのレベルで満足することを見い出した。

次に、本発明の構成を詳述する。

本発明にかかる導電性ペイントは、その導電粉が少なくともAg 10~70重量%とBa 0.1~3重量%を含有し、残部がCuという組成のAg-Ba-Cu合金粉であることを特徴とする導電性ペイントである。

この種の樹脂硬化型の導電性ペイントの導電粉において望まれる条件は、

- a、導電性があること
- b、加熱硬化時における耐熱酸化性があることがあげられる。

る。また、合金元素としてのBaの添加は、Ag-Cu合金粉の耐熱酸化性をも改善する傾向にある。これは、Ba酸化物が合金粉の過度の酸化を防止しているものと推察される。さらに、Ba自身の耐環境性によっても、その添加により耐食性の効果を呈するものと考えられる。しかしながら、Baの添加量が適量を越えると、合金粉自体の導電性が低下すること、機械的加工能が低下し、微粉化が困難なことなどにより望ましい特性は得られない。

Ag-Ba-Cu合金粉が導電性ペイントの導電粉として、上述の長所を見い出しうる合金組成は、Ag 10~70重量%、Ba 0.1~3重量%、残部Cuである。Agの下限は合金粉の耐熱酸化性から、上限は経済性からそれぞれ制約される量である。

また、Ba量の下限はその添加効果を見い出しうる最少量、上限は合金粉の作製上から制約される量である。

以上のように、Ag-Ba-Cu合金粉を用いた導電性ペイントは、導電性、耐マイグレーション性の面で実用上十分な性能を見い出しうるものである。

合金粉の一成分であるCuは、導電性にすぐれた金属であるが、耐熱酸化性、耐食性は良いとは言えない。したがって、ペイント硬化処理における加熱によって、しばしばCu粉の表面に多量の酸化スケールが発生し、ペイント硬化膜の十分な導電性が得られない。このようなCu粉の欠点は、合金元素としてAgを添加することにより改善される。しかしながら、耐マイグレーション性において、Cuがマイグレーションを起こしにくいことから、Ag-Cu合金粉はAg粉に較べると改善される傾向にあるが、十分な耐マイグレーション性は得られない。このようなAg-Cu合金粉の難点は、さらにBaを合金元素として添加することにより大幅に改良される。合金化が何故にこのような耐マイグレーション性の改良をもたらすかは明確ではないが、Ba自身がマイグレーションを起こしにくいことと、BaがAgに較べて極めて卑な金属であるということがAg-Ba-Cu合金粉が導電性ペイントとして使用された場合のすぐれた耐マイグレーション性をひき出しているものと推察され

しかしながら、一般的にCuおよびCu系合金の耐食性は過度の腐食環境においては必ずしも良好ではないように、本発明における合金粉においても、そのような雰囲気に放置された場合、耐食性は必ずしも満足できるものではない。しかして、このような欠点は、合金粉に1,2,3-ベンゾトリアゾールをアセトンキなどの有機溶媒に溶かした溶液に浸漬した後、溶液を分離して乾燥させるという処理（以下、ベンゾトリアゾール処理と呼ぶ）により解決される。推察するに、上記のベンゾトリアゾール処理によって合金粉表面に薄いキレート化合物の皮膜を形成することにより、防食効果を発揮しているものと思われる。

本発明に従えば、Ag-Ba-Cu合金粉、あるいは、ベンゾトリアゾール処理を行なったAg-Ba-Cu合金粉を、熱硬化型の樹脂と溶剤と共に混練して導電性ペイントとなす。この導電性ペイントは、通常のAgペイントと同様にフェノール樹脂基板等にスクリーン印刷等の方法で塗布した後、大気中で加熱硬化して、電極や導電路として利用さ

分に分散させた。この後、合金粉と溶液を分離し、合金粉を乾燥した。

以上の方針によって得られた合金粉2タ、あるいはベンゾトリアゾール処理を行なった合金粉2タを、キシレン樹脂1タ、エチルカルビトール0.2タと共に、フーバーマーラを用いて混練した。フーバーマーラによる混練は、荷重100ポンド、40回転を4回繰り返して行なった。

上記作製した導電性ペイントをスクリーン印刷法を用いてフェノール樹脂基板上に所定の形状に印刷後、大気中190℃10分間の条件で加熱硬化した。

上記印刷パターンの両端間の抵抗値を測定した結果と、さらに40℃95%RHの恒温恒湿槽に120時間放置した後で測定した結果を次表に示す。表には、市販のAg粉、Cu粉を導電粉とした場合の結果を併せて示す。

(以下余白)

導電粉合金組成 (重量%)	ベンゾトリ アゾール 処理の有 無	面抵抗 (Ω/□)		備考
		加熱硬化後	恒温恒湿槽に 放置後	
10Ag-0.5Be-残Cu	無	1~4	2~7	本発明
	有	1.5~4	2~6	*
50Ag-3Be-残Cu	無	0.2~0.75	0.3~0.85	*
30Ag-0.1Be-残Cu	無	0.5~0.6	0.5~1	*
	有	0.35~0.6	0.4~0.8	*
70Ag-1Be-残Cu	無	0.07~0.2	0.1~0.25	*
Cu	無	10~50	∞	参考
	有	25~80	310~680	*
Ag	無	0.005~0.05	0.005~0.05	*

また、耐マイグレーション性の試験として、上記作製したペイントを、フェノール樹脂基板上に、間隙0.6mmのパターンをスクリーン印刷し、加熱硬化させた後、間隙部に純水0.2mlを滴下した状態で、間隙間に直流3Vの電圧を印加し、間隙間に流れる電流を測定したところ、電圧印加後2時間経過後の電流値は、いずれも10μA程度であった。これに対し、Ag粉を導電粉としたペイントについて同様の試験を行なったところ、電圧印加後1分間経過時点で間隙部でAgの移行が観察される短絡を起こした。したがって、本発明にかかる導電性ペイントは、従来のAgペイントに較べて、耐マイグレーション性が極めてすぐれていると言える。

上記した説明および表から明らかのように、本発明にかかる導電性ペイントは、従来のAgペイントに比較して、導電性、耐食性の面で多少劣る面があるものの、十分実用に供し得る特性を示すものであり、特に耐マイグレーション性にすぐれしており、経済的には従来のAgペイントに較べて極め

て安価に作製し得ることから、その工業的価値は
大なるものがある。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名